

関係各位

レンゴー株式会社
広報部広報課

レンゴーは『東京パック 2018』に出展します

来たる10月2日より、東京ビッグサイトにて2018東京国際包装展(東京パック2018)が開催され、当社も出展いたします。

当社ブースでは、『クロス・イノベーションで、その先へ』をテーマに、レンゴー独自の技術や発想をクロスさせる(掛け合わせる)ことで生まれた、一歩先をゆくパッケージング・イノベーションの数々をご紹介します。

人手不足や配送問題など喫緊の社会的課題を解決するパッケージング・ソリューションとして、小売店での開梱・陳列の作業性を飛躍的に改善するリテールメイトシリーズや、物流センターでの包装工程を自動化するジェミニ・パッケージングシステムなど幅広く展示するほか、デジタル印刷が拓くこれまでにないパッケージの新たな活用事例もご覧いただけます。

より少ない資源で大きな価値を生む“Less is more.”をコンセプトに、包装の新たな価値を創造し続ける「ゼネラル・パッケージング・インダストリー」=GPIレンゴーの最先端を是非ともご覧賜りたくご案内申し上げます。

<東京パック 2018 概要>

1. 名 称 2018 東京国際包装展 ―東京パック 2018― <http://www.tokyo-pack.jp/>
1966年から開催されるアジア地域最大規模の国際包装展です。
2. 日 程 2018年10月2日(火)～10月5日(金) 10:00～17:00
3. 場 所 東京ビッグサイト(東京国際展示場)東展示棟1～6ホール
東京都江東区有明3-11-1
4. 主 催 公益社団法人日本包装技術協会(JPI)
5. レンゴー出展ブース小間位置 東1ホール 1-17
6. 入場無料 ※入場には、ご登録が必要です。



以上